公司代码：688720 公司简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本88,133,334股，扣减回购专用证券账户中股份总数225,073股后为87,908,261股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币13,186,239.15元（含税）。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	艾森股份	688720	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈小华	徐雯
办公地址	江苏省昆山市千灯镇中庄路299号	江苏省昆山市千灯镇中庄路299号
电话	0512-50103288	0512-50103288
电子信箱	ir@asem.cn	ir@asem.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务基本情况

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案（Turnkey），满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

2、主要产品基本情况

公司自成立以来，紧抓产业历史机遇，通过持续自主研究开发，不断在关键半导体材料上实现突破。公司以半导体传统封装的电镀产品起步，逐步掌握了引脚表面处理的全套电子化学品，具体包括电镀液和电镀前后处理化学品。经过多年努力，公司逐步取代国外材料公司成为传统封装电镀化学品领域的国内主力供应商，并逐步向先进封装、晶圆制造及显示面板等领域延伸，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块。

（1）电镀液及配套试剂

①电镀液

电镀液是半导体制造过程中的核心材料之一，由主盐、导电剂、络合剂及各类电镀添加剂组成，其中电镀添加剂是影响电镀功能的核心组分。传统封装领域，公司的电镀液产品主要应用于芯片引脚表面镀锡，主要为基于甲基磺酸的电镀体系，系通过电化学方法在集成电路或电子元件引脚表面沉积一层均匀、致密的纯锡镀层，利用锡导电性好、易钎焊的特性实现集成电路、电子元件与印刷电路板之间良好的焊接和导电性能。

在传统封装产品的基础上，报告期内公司电镀液产品逐步向外资厂商垄断的先进封装及晶圆制造领域延伸。随着集成电路中互连层数、先进封装中对RDL和铜柱结构使用的增加，铜互连材料需求将持续增长。公司的先进封装电镀产品主要用于先进封装Bumping工艺凸块的制作，可以实现芯片与晶圆、载板之间的电气连接。

②电镀前处理化学品

集成电路或电子元件在进入电镀液以前的加工处理和清理工序总称为电镀前处理（或预处理）。针对电镀前处理各工艺步骤，公司提供的电镀前处理化学品包括祛毛刺液、除油剂、去氧化剂、活化剂、化抛液等。

③电镀后处理化学品

集成电路或电子元件在电镀后的加工处理和清理工序总称为电镀后处理。电镀后处理化学品主要有两类用途：一类用于提高镀层表面质量及抗腐蚀性，有效提高集成电路或电子元件长期存储、高温回流焊的可靠性；另一类用于对电镀治具上残留的镀层进行退镀，以提高电镀效率。针对电镀后处理各工艺步骤，公司提供的电镀后处理化学品包括中和剂、退镀液等。

（2）光刻胶及配套试剂

①光刻胶

根据应用领域，光刻胶可分为PCB光刻胶、显示面板光刻胶和集成电路光刻胶（可进一步细分为先进封装和晶圆制造），其技术壁垒依次提升。国产光刻胶发展起步较晚，与国外先进光刻胶技术相比，国内产品仍有较大差距，目前主要集中在PCB光刻胶、TFT-LCD光刻胶等产品，国内集成电路光刻胶及OLED显示面板光刻胶仍由国外企业占据主导地位。

公司以先进封装负性光刻胶、OLED阵列制造用光刻胶以及晶圆用PSPI等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及显示面板等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸。

②光刻胶配套试剂

公司光刻胶配套试剂主要应用于先进封装领域。先进封装要求在晶圆划片前融入封装工艺步骤，具体包括晶圆研磨薄化、线路重排（RDL）、凸块制作（Bumping）及三维硅通孔（TSV）等工艺技术，涉及与晶圆制造相似的涂胶、显影、去胶、蚀刻等工序步骤。报告期内，公司应用于先进封装领域光刻胶配套试剂已经实现批量供应，主要产品包括附着力促进剂、显影液、蚀刻液、去除剂等。

（3）电镀配套材料

除电子化学品外，公司还可以提供电镀工艺配套的锡球、镍饼等阳极金属材料及阳极袋、退镀用胶条等辅材，以满足客户的整体需求。公司销售的锡球主要采用外协加工模式。

（4）其他电子化学品

其他电子化学品主要为感光油墨。感光油墨对紫外线敏感，并且能通过紫外线固化，主要用于PCB电子线路板自动化生产制造中的文字打印等。

(二)主要经营模式

1、销售模式

公司产品销售为直销模式。公司建立了较为完善的市场营销体系，与国内多家知名半导体封测厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司的产品销售流程包括了解客户需求、取得测试机会、通过客户测试、通过终端客户测试（如有）、小规模量产（如有）及批量供货。

公司有能力为客户提供Turnkey整体解决方案，即除了提供实现特定功能相匹配的电子化学品及配套材料外，还能够提供与产品相适应的应用工艺方案和技术支持等，使得相关产品能够适配不同客户的产线标准和生产工艺，满足下游产品的功能、质量要求。

按照公司向客户交货及结算模式，可以分为非寄售模式和寄售模式两类。非寄售模式下，根据销售合同或订单约定，公司将商品发运至客户指定地点并经客户确认收货时实现销售；寄售模式下，公司根据销售合同或订单的约定将商品发运至客户指定地点，在客户实际领用时实现销售。

2、采购模式

采购环节是公司品质控制和成本控制的关键环节。公司制定了《采购控制程序》《供应商管理办法》等制度对采购活动进行严格控制。

采购管理部负责开发供应商，组织对供应商的评审，建立合格供应商名录和档案，定期对供应商进行评定，及时调整合格供应商名单。采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等向供应商下发采购订单。公司基于市场行情、向供应商询价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。

3、生产模式

公司主要按照以销定产的总体原则安排生产计划，分为按计划生产和按需生产两种生产模式。

在按计划生产的模式下，公司根据客户销售需求，综合考虑安全库存量和生产能力，制定生产计划。计划人员会根据近三个月的销售情况与销售部门确认后制定生产计划，一般情况下公司制定的生产计划能够满足客户的定期下单需求。按需生产的模式，是指在客户临时加单的情况下，公司根据临时加单的需求，针对性安排额外的生产计划。

4、研发模式

公司研发流程主要包括以下过程：

（1）研发立项阶段

研发部门设立年度/月计划，以对研发项目实施总体规划。研发项目因市场调研情况及产品规划开立课题，由各产品事业部或研发部负责人收集信息、分析需求，并出具相关的需求报告，经研发总监或研发经理审核通过后提交管理层会议审议，审议通过后进行相应的项目立项。项目通过可行性评估后，签发研发任务给研发部。研发部负责人确定项目负责人，研发任务转化为研发计划。

（2）研发需求确认阶段

项目负责人根据研发计划的规划，确定研发的需求，主要包括以下内容：①产品的主要性能指标，主要来源于应用需求；②法律法规及国家相关强制性标准；③历史类似研发项目积累的适用信息；④新产品安全性和适用性至关重要的特性要求，如安全、包装、运输、贮存、环境、卫生等。

（3）产品设计及实验室小试阶段

项目负责人根据研发需求，在实验室内组织开展配方设计及测试评估工作，并根据测试结果优化调整配方。

（4）样品试制及研发验证阶段

研发部组织有关部门评审研发项目的阶段性结果。研发部负责人负责审核样品试制技术要求，并核准试制样品。试制完成的样品由研发部安排进行产品性能验证，样品检验合格的进入下一研发阶段。如不合格，研发部门分析技术原因，并重新试制或变更配方设计。

为确保产品能够满足客户的使用及预期用途要求，公司送样至客户现场，使用客户的产线资源对样品进行验证。

（5）中试及产品认证阶段

研发部门完成工艺标准和控制标准的制定，并根据研发验证结果持续优化和调整产品，直至研发成果通过客户实际产线测试，完成最终产品认证。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司所处行业

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、显示面板及新型电子元器件等行业。按照行业的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

（2）行业的发展阶段及细分领域市场情况

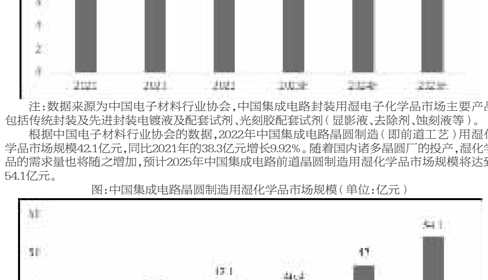
①集成电路湿电子化学品

根据中国电子材料行业协会的数据，全球在集成电路、显示面板、光伏三个应用领域所使用湿化学品量的比例约为46%、36%及18%。集成电路是湿化学品的主要应用领域，全球湿化学品需求增长的主要驱动力来源于对集成电路持续增加的需求及多座晶圆厂的建成投产。

国内湿化学品行业近年来取得了长足进步，但高速发展的同时，也存在着部分瓶颈。湿化学品行业投资大，产品获认证过程繁琐，周期长，生产商需长期投入、持续研发，还需配备高素质从业人员。国产湿化学品与国外龙头企业美国杜邦、德国BASF等相比，在高端产品性能及规模上尚有较大差距，缺乏在多个品种均拥有较高市占率的龙头企业，特别是在集成电路先进制程用产品上差距明显。

公司的电镀液及配套试剂、光刻胶配套试剂主要面向集成电路封装湿电子化学品市场。根据中国电子材料行业协会的数据，2022年中国集成电路封装（含传统封装与先进封装）用湿化学品市场规模14.8亿元，同比2021年的13.8亿元增长7.25%。随着晶圆制造工艺的不断提升，对与之配套的封测技术同步要求提高，传统封装技术的发展将趋于平稳，先进封装技术的应用将进一步加强，对湿化学品的需求量也将随之增加，预计2025年中国集成电路封装用湿化学品市场规模将达到17.2亿元。

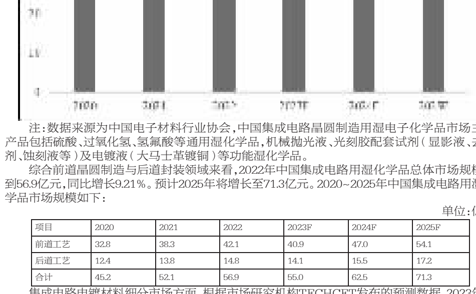
图：中国集成电路封装用湿化学品市场规模（单位：亿元）



注：数据来源为中国电子材料行业协会，中国集成电路封装用湿电子化学品市场主要产品包括传统封装及先进封装电镀液和配套试剂、光刻胶配套试剂（显影液、去除剂、蚀刻液等）。

根据中国电子材料行业协会的数据，2022年中国集成电路晶圆制造（即前道工艺）用湿化学品市场规模42.1亿元，同比2021年的38.3亿元增长9.92%。随着国内诸多晶圆厂的投产，湿化学品的需求量也将随之增加，预计2025年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模将达到54.1亿元。

图：中国集成电路晶圆制造用湿化学品市场规模（单位：亿元）



注：数据来源为中国电子材料行业协会，中国集成电路晶圆制造用湿电子化学品市场主要产品包括硫酸、过氧化氢、氢氟酸等通用湿化学品，机械抛光液、光刻胶配套试剂（显影液、去除剂、蚀刻液等）及电镀液（大马士革镀铜）等功能湿化学品。

综合前道晶圆制造与后道封装领域来看，2022年中国集成电路用湿化学品总体市场规模达到56.9亿元，同比增长9.21%。预计2025年将增长至71.3亿元。2020~2025年中国集成电路用湿化学品市场规模如下：

单位：亿元

项目	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F
前道工艺	32.8	38.3	42.1	40.9	47.0	54.1
后道工艺	12.4	13.8	14.8	14.1	15.5	17.2
合计	45.2	52.1	56.9	55.0	62.5	71.3

集成电路电镀材料细分市场方面，根据市场研究机构TECHCET发布的预测数据，2023年全球半导体电镀化学品市场规模预计为9.92亿美元，而2024年预计达到10.47亿美元，预计增速为5.6%，主要增长动力包括集成电路中互连层的增加、先进封装中对RDL和铜凸块的使用等。由于继续沿用大马士革工艺镀铜布线，先进工艺节点逻辑器件中对铜互连材料需求将持续增长。铜互连材料是晶圆制造及先进封装电镀材料最大的细分市场，2021-2026年复合年化增长率预计为8.6%。

②光刻胶市场概况

光刻胶是技术壁垒最高的电子化学品之一。我国光刻胶产业，特别是集成电路用光刻胶，长期以来发展较为缓慢。2008年以后，在国家重大科技专项的支持和国内集成电路产业快速成长的带动下，这种局面得到了一定程度的改变，陆续有公司关注集成电路用光刻胶及其相关产品产业化技术开发，并有部分产品进入市场应用。但是，目前国内光刻胶仍主要集中在PCB光刻胶、TFT-LCD光刻胶等产品，在OLED显示面板和集成电路用光刻胶等高端产品仍需大量进口，国产光刻胶正处于由中低端向中高端过渡阶段。

按曝光光源波长划分，光刻胶可分为g线光刻胶（436nm）、i线光刻胶（365nm）、KrF光刻胶（248nm）、ArF光刻胶（193nm）和EUV光刻胶（13.5nm）。根据中国电子材料行业协会的数据，当前我国g/i线光刻胶的国产化率约为20%，仍处于较低水平，KrF光刻胶整体国产化率不足2%，ArF光刻胶整体国产化率不足1%。

根据中国电子材料行业协会的数据，2022年中国集成电路g/i线光刻胶市场规模总计9.14亿元，预计到2025年将增长至10.09亿元，其中，2022年中国集成电路封装用g/i线光刻胶市场规模5.47亿元，预计2025年将增长至5.95亿元。根据中国电子材料行业协会的数据，中国集成电路用g/i线光刻胶的具体市场规模如下：

单位：亿元

项目	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F
晶圆制造用g/i线光刻胶	2.63	3.19	3.67	3.48	3.76	4.14
封装用g/i线光刻胶	4.42	4.95	5.47	5.25	5.51	5.95
合计	7.05	8.14	9.14	8.73	9.27	10.09

显示面板领域，随着TFT-LCD面板产能逐渐向中国大陆转移，产业链配套的要求使得大陆对TFT-LCD光刻胶的需求快速增长。与此同时，多条OLED产线的规划与投产也将带动相关领域对光刻胶的需求增长。由于显示面板涂布面积大，显示面板用光刻胶用量及市场规模大于集成电路市场。

在PSPI（光敏聚酰亚胺）方面，PSPI同样采用g/i线曝光光源，既起光刻作用又是介电材料，用于制作集成电路中的阻挡层，用于特定绝缘和保护作用，形态完成后保留在晶圆上无需去除，对可靠性要求更高，技术难度甚至高于光刻胶。目前国内PSPI产品依然高度依赖从如HDM公司、东丽公司等美国、日本厂商进口。根据中国电子材料行业协会数据，2021年中国集成电路晶圆制造用PSPI市场规模7.12亿元，预计到2025年中国集成电路晶圆制造用PSPI市场规模将增长至9.67亿元。

③下游应用领域——全球封装的发展趋势

A.封装技术持续演进趋势，先进封装重要性凸显

根据《中国半导体封装业的发展》，迄今为止全球封装技术一共经历了五个发展阶段。当前，从技术成熟度而言，全球封装行业的主流技术以第三阶段为主，并向以系统级封装（SiP）、倒装焊封装（FC）、扇出型集成电路封装（Fan-Out）等为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

阶段	起始时间	封装形式	具体典型的封装形式
第一阶段	20世纪70年代以前	通孔插装型封装	晶体管封装（TO）、陶瓷双列直插封装（CDIP）、塑料双列直插封装（PDIP）、单列直插式封装（SIP）等
第二阶段	20世纪80年代以后	表面贴装型封装	塑料有引线片式载体封装（PLCC）、塑料四边引线扁平封装（PQFP）、小外形表面封装（SOP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、双边扁平无引脚封装（DFN）等
第三阶段	20世纪90年代以后	球栅阵列封装（BGA）	塑料焊球阵列封装（PBGA）、陶瓷焊球阵列封装(CBGA)、带散热器焊球阵列封装（EBGA）、倒装芯片焊球阵列封装（FC-BGA）
		晶圆级封装(WLP)	
		芯片级封装（CSP）	引线框架型CSP封装、柔性插入板CSP封装、刚性插入板CSP封装、圆片级CSP封装
第四阶段	20世纪末开始	多芯片组封装（MCM）	多层陶瓷基板（MCM-C）、多层薄膜基板（MCM-D）、多层印制板（MCM-L）
		系统级封装（SiP）、芯片上制作凸点（Bumping）	
第五阶段	21世纪前十年开始	晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、扇出型集成电路封装（Fan-Out）、三维立体封装（3D）等	

尽管近几年来国内领先封装企业通过自主研发和收购兼并等方式逐步掌握第三、四、五阶段的部分先进封装技术，但技术发展先于市场，国内封装行业整体发展水平与境外仍存在一定的差距，主流封装产品已覆盖至第四阶段。公司能够提供的不同封装技术产品具体如下：

封装技术发展阶段	对应封装形式	公司对应产品	产品所处阶段
第一阶段	TO、DIP等	电镀液及配套试剂（传统封装）	批量供应
第二阶段	SOT、SOP等	电镀液及配套试剂（传统封装）	批量供应
第三阶段	QFN等	电镀液及配套试剂（传统封装）	批量供应
第四、第五阶段	Bumping、TSV等	电镀液及配套试剂（先进封装）、光刻胶及配套试剂	光刻胶配套试剂及部分型号光刻胶已批量供应；部分型号光刻胶处于小批量供应阶段；电镀铜基液（高纯硫酸铜）已批量供应，电镀锡银添加剂已通过客户认证，尚待终端客户测试通过

B.先进封装工艺环节类似晶圆制造，是集成电路制造的重要发展方向

随着电子产品进一步朝向小型化与多功能的发展，集成电路尺寸越来越小、集成电路种类越来越多、线宽越来越细，接口密度不断提升，先进封装技术成为未来集成电路制造的重要发展方向。先进封装技术通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式提升集成电路的连接密度和集成度。

根据Yole的数据，预计2028年先进封装全球市场规模约786亿美元，占比约54.8%。2022年至2028年，相比同期全球整体封装市场（年复合增长率约为7.1%），全球先进封装市场的年复合增长率约为10%，先进封装市场的增长更为显著，将成为全球封装市场的主要增量。

（3）行业基本特点及主要技术门槛

①行业基本特点

A.国家政策与产业资本支持力度大

公司所属半导体材料行业为国家重点支持和鼓励发展的行业。目前，国务院、国家发改委、工信部、商务部以及科技部等多个机构和部门均通过各类纲领性文件、政策性文件、发展规划以及指导性文件等在多层次、多方面、多角度对半导体材料全产业链给予了大力支持，为半导体材料行业提供了有力的发展支撑以及良好的营商环境。

此外，光刻胶领域受到了国家政策的特别支持，国家发改委于2020年9月出台了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，工信部于2019年11月将"集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂"列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》。公司所在行业将在产业政策的指导下，获得更大的发展空间。

B.晶圆制造产能提升带动材料需求增长，市场空间未来发展潜力巨大

半导体晶圆制造材料和晶圆制造产能密不可分，晶圆制造为半导体材料行业重要下游产业。

根据SEMI最新的《世界晶圆厂预测报告》（World Fab Forecast），预计中国芯片制造商2024年将展开18座新晶圆厂，产能年增率将从2023年的12%提升至2024年的13%，产能将从760万片推升成长至860万片。随着半导体产业向中国大陆转移，中国晶圆产能随之将持续提升。根据CEMIA统计，2020-2025年，我国新增集成电路晶圆生产线主要集中在12英寸和8英寸。按2020年现有规划，2022年12英寸晶圆产能较2019年预计提升超100万片/月，8英寸晶圆产能预计提升超30万片/月，晶圆产能的提升将带动湿化学品及光刻胶需求快速增加。

C.半导体材料国产化趋势明显

根据中国电子材料行业协会的数据，我国集成电路晶圆用湿化学品整体国产化率38%，先进技术节点所用的功能湿化学品基本依赖于进口，先进封装用电镀添加剂市场主要由国外企业主导，核心技术难题亟需尽快突破。

光刻胶是电子化学品中技术壁垒最高的材料，长期以来，我国光刻胶产业整体上处于缓慢的发展状态，特别是在集成电路用光刻胶方面。国产光刻胶以PCB、TFT-LCD领域为主，集成电路用光刻胶主要依靠进口。根据中国电子材料行业协会的数据，2021年国内集成电路用i/g线光刻胶国产化率20%左右，KrF光刻胶国产化率不足2%，ArF光刻胶国产化率低于1%，核心技术难题急需尽快突破。目前我国正急需解决半导体材料领域核心技术的"卡脖子"问题，湿化学品及光刻胶领域国产化趋势拓展出了巨大的市场空间。

D.客户认证周期较长

公司客户所处的集成电路、电子元件及显示面板行业对电子化学品等材料供应商的产品质量和供货能力十分重视，产品通常需要经过客户的严格认证。电子化学品行业认证周期较长，新产品从研发到正式投入产业化需要经历相当长的时间，需要通过客户长期的严格认证。

②主要技术门槛

电镀液及配套试剂属于功能湿电子化学品，是应用于集成电路制造的关键材料，主要技术壁垒体现在复配配方、生产工艺及产品质量把控，需要研发企业具备电镀领域具体实践经验积累。

同时，电镀液产品实现量产前还需要通过下游客户测试认证，研发企业获得测试认证的机会具有较高的技术门槛。集成电路封装领域中应用电镀工艺沉积的金属层与构成集成电路的组成部分，直接影响产品的良率及性能。封测厂商及芯片的终端客户对于这类直接材料的引进、更换一般持有较为谨慎的态度。因此，客户通常更愿意与具有成熟行业经验、优秀技术实力的供应商合作，一般电子化学品企业较难获得测试认证的机会。

公司光刻胶配套试剂与电镀液及配套试剂同属于应用于集成电路封装的功能湿电子化学品，具有类似的技术壁垒，其体现在复配配方、生产工艺及产品质量把控，需要研发企业具备先进封装光刻工艺的具体实践经验积累，并能够获得下游客户测试认证的机会且实现商业化应用，具有较高的技术门槛。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

在功能湿化学品及光刻胶领域，国外企业的优势明显，先进封装用电镀化学品及光刻胶产品中国外企业更是占据的市场主导地位，全球主要供应商均为国际公司，包括美国杜邦、日本JSR、日本TOK、德国Merck等。

功能湿化学品及光刻胶技术门槛高，国内化学品企业市场份额与国际领先相比差距较大，目前国内能量产并形成供应的仅有电镀液、硅蚀刻液、28nm以上技术节点用负性光刻胶去除剂等。根据中国电子材料行业协会的数据，2022年，我国集成电路用湿化学品整体国产化率达到38%，g/i线光刻胶领域国产化率不足20%，KrF光刻胶整体国产化率不足2%，ArF/ArFi光刻胶整体国产化率不足1%。

公司注重产品研发和技术积累，以半导体传统封装电镀系列化学品起步，经过数年内努力技术攻坚，不断取代国外材料公司在该领域的市场份额，成为该领域的主力供应商，目前国内市场份额处于领先位置。根据中国电子材料行业协会的数据，2020年至2022年，公司在集成电路封装（含集成电路先进封装及传统封装）用电镀液及配套试剂市场占有率（按销售量计算）均超过20%，排名国内前二。

公司在先进封装、晶圆制造及OLED阵列制造领域的电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等领域已经实现技术突破，上述领域的相关产品目前仍主要由国外企业供应。公司相关产品的技术突破和规模供应有助于提高我国在半导体关键材料领域的竞争力。

集成电路封测厂商市场集中度高，根据芯思想的数据，2023年度，全球前十大封测公司的收入占封测市场整体营收的77.65%。其中，中国大陆排名前三的为长电科技、通富微电、华天科技，合计市占率为22.16%。公司与长电科技、通富微电、华天科技国内前三大封测厂商均建立了稳定的合作关系，并批量供应电镀液及配套试剂、光刻胶配套试剂，部分光刻胶及先进封装用电镀添加剂产品已通过其认证。公司与主流封测厂商建立了稳定合作关系，公司优秀的技术能力及与客户的信任关系有利于推动公司与下游客户协同推进半导体关键材料的国产化进程。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）湿化学品

半导体行业，尤其是集成电路制造工艺变得越来越复杂，对湿法工艺的技术要求不断提高，湿化学品质量对产品良率、电性能及可靠性的影响程度越来越高。

对于功能湿化学品来说，由于新结构、新器件和新材料的不断引入，主流芯片制造企业间的差异性越来越大，满足市场各类功能需求将成为未来发展的重要趋势，比如达到特定刻蚀、电镀和清洗工艺需求的同时减少对衬底材料的损失，改善晶片表面微观特征，减小产品缺陷率，提升产品良率和可靠性等。

公司通过不断的产品验证和测试，在集成电路封装电镀领域国内市场份额超过20%，系国内传统封装电镀化学品的主力供应商。此外，公司还不断开发晶圆制造及先进封装领域的电镀产品，先进封装用Bumping电镀添加剂已通过长电科技认证，晶圆制造用大马士革铜工艺镀铜添加剂产品已进入样品试制和产品认证阶段。根据中国电子材料行业协会的数据，公司目前已成为国内集成电路用电镀液及添加剂的主要供应商。

（2）光刻胶

在芯片前道制程延续摩尔定律往小尺寸方向发展演进的同时，芯片封装领域也不断出现新的封装形式的创新，其中Bumping工艺是近20年来先进封装形式取得快速发展的核心基础工艺，各类芯片的封装形式也越来越普遍地采用先进封装方式，使先进封装成为当下集成电路的重要发展方向。

在先进封装领域，线路重排（RDL）、硅通孔（TSV）、凸块（Bumping）等技术在高性能芯片封装产品上得到越来越多的应用。进而对光刻胶提出了越来越复杂的设计和制造要求。

我国光刻胶行业发展起步较晚，需求量远远大于产量。国内光刻胶产量主要集中于PCB领域、TFT-LCD领域，晶圆制造、先进封装及OLED显示面板用光刻胶仍严重依赖进口。

面对这一情况，公司近年来针对晶圆制造、先进封装及OLED显示面板用光刻胶进行产品开发。先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技的认证并实现批量供应；OLED阵列制造用正性光刻胶（应用于两膜层）及晶圆制造i线正性光刻胶已分别通过京东方及华虹宏力的认证并开始小批量供应。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,279,889,093.54	562,255,979.00	127.63	535,610,423.23
归属于上市公司股东的净资产	1,016,246,943.63	441,186,438.38	130.34	421,757,569.38
营业收入	360,039,281.45	323,766,288.78	11.20	314,478,827.55
归属于上市公司股东的净利润	32,657,327.71	23,284,746.48	40.25	34,990,369.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,164,699.66	14,403,274.36	88.60	29,605,072.12
经营活动产生的现金流量净额	-84,531,832.72	-48,497,230.55	不适用	-108,625,591.28
加权平均净资产收益率（%）	7.17	5.37	增加1.80个百分点	10.52
基本每股收益（元/股）	0.49	0.35	40.00	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.35	40.00	0.55
研发投入占营业收入的比例（%）	9.08	7.32	增加1.76个百分点	7.47

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	71,666,840.38	82,361,977.11	93,902,575.16	112,107,888.80
归属于上市公司股东的净利润	3,537,777.14	7,580,832.82	7,417,949.17	14,120,768.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,411,338.40	7,497,182.92	7,033,626.32	9,222,552.02
经营活动产生的现金流量净额	-26,640,915.63	-26,101,206.93	-16,815,550.02	-14,974,160.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,890
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
张兵	0	19,031,621	21.59	19,031,621	19,031,621	无	0	境内自然人
蔡卡敦	0	6,847,826	7.77	6,847,826	6,847,826	无	0	境内自然人
昆山艾森投资管理企业（有限合伙）	0	5,869,565	6.66	5,869,565	5,869,565	无	0	其他
昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,335,968	6.05	5,335,968	5,335,968	无	0	其他
北京芯动能投资基金（有限合伙）	0	4,398,164	4.99	4,398,164	4,398,164	无	0	其他
天津宸晖投资管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,066,418	4.61	4,066,418	4,066,418	无	0	其他
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	0	2,600,000	2.95	2,600,000	2,600,000	无	0	境内非国有法人
华泰证券资管－宁波银行－华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	2,161,969	2,161,969	2.45	2,161,969	2,161,969	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	1,936,886	1,936,886	2.20	165	165	无	0	其他
庄建华	0	1,636,364	1.86	1,636,364	1,636,364	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	张兵与蔡卡敦系夫妻关系；张兵为艾森投资普通合伙人及执行事务合伙人，持有艾森投资37.90%的财产份额；张兵、蔡卡敦和艾森投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

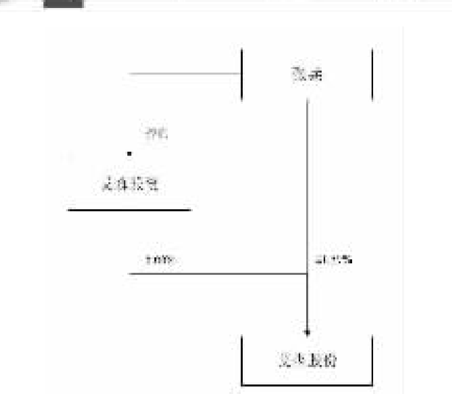
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

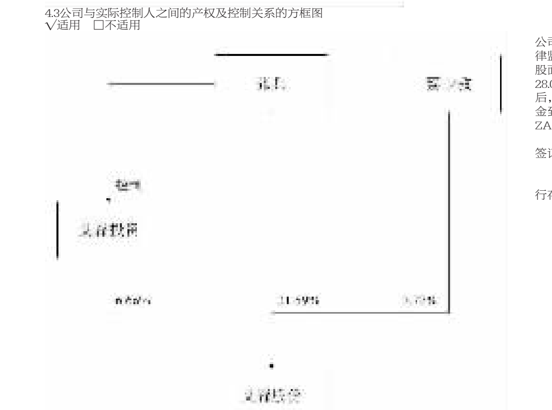
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司克服半导体行业下行周期等不利因素，南通工厂新建产能持续释放。全年实现营业收入36,003.93万元，同比增加11.20%；实现归属于上市公司股东的净利润3,265.73万元，同比增加40.25%。主要经营情况详见本节"经营情况讨论与分析"。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-028

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行募集资金总额为人民币617,594,352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为544,497,129.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币353,050,519.51元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2023年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	617,594,352.02
减：保荐及承销费用	46,278,925.58
实际银行到账余额	571,315,426.44
减：募集资金项目投入	13,187,836.72
发行费用	136,158.32
以闲置募集资金购买理财产品	205,000,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
募集资金专项账户手续费支出	225.00
注销募集账户利息余额转出	-
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	-
募集资金理财产品利息收益	-
募集资金专项账户存款利息收入	59,313.11
募集资金专项账户余额	353,050,519.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023年12月，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司共有4个募集资金专户和3个通知存款账户，本年度募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391064700013000424409	781,246.28	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	51433700001579	13,603,114.42	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	55,163,687.26	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	13,502,471.55	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391899999603000019728	210,000,000.00	7天通知存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	52197300000476	30,000,000.00	7天通知存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	86033000000141770	30,000,000.00	7天通知存款
合计		/	353,050,519.51	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2023年度公司实际募集资金项目投入13,187,836.72元，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,364.49万元，公司以自筹资金累计支付发行费611.23万元，尚未进行置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	已预先投入金额
年产12,000吨半导体专用材料项目	21,076.83	18,592.45
集成电路材料测试中心项目	28,372.88	5,772.04
发行费用	-	611.23
合计	49,449.71	24,975.72

注：2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金24,364.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金611.23万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年2月6日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-011）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，公司董事会及监事会同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年12月12日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存

下转B556

证券代码：688720 证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	81,859,701.74	14.22
归属于上市公司股东的净利润	7,510,130.00	112.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,599,134.29	5.51
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,362.31	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00
加权平均净资产收益率（%）	0.74	-0.06
研发投入合计	9,850,720.21	14.22
研发投入占营业收入的比例（%）	12.03	4.28

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,276,757,850.25	1,279,889,093.54	-0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,019,917,315.37	1,016,246,943.63	0.36

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,871.57	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,472,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,436,034.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	983,567.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,910,995.71	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	112.28	主系营业收入的增长、政府补助及资金管理收益的增长所致
基本每股收益（元/股）	80.00	主系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）	80.00	主系归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张兵	境内自然人	19,031,621	21.59	19,031,621	19,031,621	无	0
蔡卡敦	境内自然人	6,847,826	7.77	6,847,826	6,847,826	无	0
昆山艾森投资管理企业（有限合伙）	其他	5,869,565	6.66	5,869,565	5,869,565	无	0
昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	5,335,968	6.05	5,335,968	5,335,968	无	0
北京芯动能投资基金（有限合伙）	其他	4,398,164	4.99	4,398,164	4,398,164	无	0
天津宸晖投资管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,066,418	4.61	4,066,418	4,066,418	无	0
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	境内非国有法人	2,600,000	2.95	2,600,000	2,600,000	无	0
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	其他	2,263,188	2.57	165	2,263,188	无	0
华泰证券资管－宁波银行－华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	2,161,969	2.45	2,161,969	2,161,969	无	0
庄建华	境内自然人	1,636,364	1.86	1,636,364	1,636,364	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	2,263,023	人民币普通股	2,263,023
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,117,276	人民币普通股	1,117,276
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	589,039	人民币普通股	589,039
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	532,776	人民币普通股	532,776
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	475,561	人民币普通股	475,561
中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	323,072	人民币普通股	323,072
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	248,409	人民币普通股	248,409
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	217,339	人民币普通股	217,339
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	203,090	人民币普通股	203,090
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金	173,781	人民币普通股	173,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	张兵与蔡卡敦系夫妻关系；张兵为艾森投资普通合伙人及执行事务合伙人，持有艾森投资37.90%的财产份额；张兵、蔡卡敦和艾森投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司未知悉上述股东是否存在转融通业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	210,327,261.88	387,218,435.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,243,591.07	205,224,029.30
衍生金融资产		
应收票据	49,786,054.60	22,778,235.49
应收账款	145,042,312.61	152,118,862.68
应收款项融资	26,377,219.10	7,861,003.95
预付款项	9,103,528.25	3,684,052.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,089,299.68	1,172,052.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,886,244.67	39,590,439.90
其中：数据资源		
合同资产	1,532,168.21	1,581,887.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,166,262.92	54,800,943.86
其他流动资产	7,700,365.75	7,810,409.84
流动资产合计	723,254,308.74	883,840,353.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,785,272.47	231,582,055.60
在建工程	63,164,126.25	40,837,212.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,907,716.12	2,039,519.98
无形资产	11,661,841.27	11,665,364.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,220,630.13	3,189,395.67
递延所得税资产	8,811,487.00	9,257,522.92
其他非流动资产	221,952,468.27	97,477,669.59
非流动资产合计	553,503,541.51	396,048,740.40
资产总计	1,276,757,850.25	1,279,889,093.54
流动负债：		
短期借款	115,852,000.00	93,931,310.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,024,968.15	13,024,968.15
应付账款	72,443,748.93	100,158,103.38
预收款项		
合同负债	5,171,324.76	772,038.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,722,427.20	8,094,205.58
应交税费	490,223.22	983,554.72
其他应付款	455,897.48	1,087,829.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	593,598.06	589,026.76
其他流动负债	3,019,871.70	3,834,580.38
流动负债合计	215,774,059.50	222,475,617.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,039,016.32	36,039,016.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,432,673.84	1,544,005.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,594,785.22	3,583,510.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,066,475.38	41,166,532.51
负债合计	256,840,534.88	263,642,149.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,133,334.00	88,133,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,593,689.76	792,466,697.68
减：库存股	87,173.00	-
其他综合收益		
专项储备	9,948,638.44	9,828,215.78
盈余公积	15,804,879.95	15,804,879.95
一般风险准备		
未分配利润	117,523,946.22	110,013,816.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,019,917,315.37	1,016,246,943.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,917,315.37	1,016,246,943.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,276,757,850.25	1,279,889,093.54

公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：梅瑜

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	81,859,701.74	71,666,840.38
其中：营业收入	81,859,701.74	71,666,840.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,181,356.79	67,630,040.05
其中：营业成本	60,144,454.01	53,085,472.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	377,667.77	301,435.01
销售费用	6,074,348.09	4,655,934.41
管理费用	4,670,160.93	4,130,699.19
研发费用	9,850,720.21	5,555,689.63
财务费用	-1,935,994.22	-99,191.08
其中：利息费用	816,762.48	754,638.22
利息收入	2,730,326.00	1,113,359.80
加：其他收益	2,514,697.27	46,908.15
投资收益（损失以"－"号填列）	416,473.00	-21,011.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	1,019,561.77	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	556,559.24	-824,242.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-164,323.73	44,209.75
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-5,871.57	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	7,015,440.93	3,282,664.21
加：营业外收入	960,000.00	101,964.00
减：营业外支出	8,000.00	35,001.17
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	7,967,440.93	3,349,627.04
减：所得税费用	457,310.93	-188,150.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	7,510,130.00	3,537,777.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	7,510,130.00	3,537,777.14
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	7,510,130.00	3,537,777.14
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,510,130.00	3,537,777.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,510,130.00	3,537,777.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：梅瑜

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,117,003.89	58,692,011.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	284,042.99	4,905,698.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,398,512.63	180,606.03
经营活动现金流入小计	99,799,559.51	63,778,316.14
购买商品、接受劳务支付的现金	74,836,434.87	60,725,445.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,628,979.07	14,989,559.29
支付的各项税费	1,719,741.52	8,013,695.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,873,766.36	6,690,532.12
经营活动现金流出小计	118,058,921.82	90,419,231.77
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,362.31	-26,640,915.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	91,306,763.87
取得投资收益收到的现金	1,536,572.50	3,255,646.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,536,572.50	94,562,410.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,592,989.84	11,488,804.10
投资支付的现金	191,000,000.00	94,776,777.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,592,989.84	106,265,581.86
投资活动产生的现金流量净额	-134,056,417.34	-11,703,171.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,266,712.79	59,882,384.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,266,712.79	59,882,384.27
偿还债务支付的现金	42,296,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,076.15	773,477.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		101,676.29
筹资活动现金流出小计	42,551,076.15	875,154.07
筹资活动产生的现金流量净额	-24,284,363.36	59,007,230.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,496.41	-98,255.16
五、现金及现金等价物净增加额	-176,571,646.60	20,564,887.61
加：期初现金及现金等价物余额	386,898,908.48	7,843,385.34
六、期末现金及现金等价物余额	210,327,261.88	28,408,272.95

公司负责人：张兵 主管会计工作负责人：吕敏 会计机构负责人：梅瑜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日